

证券代码：688663

证券简称：新风光

新风光电子科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-003

| | |
|---------------|--|
| 投资者关系活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 |
| 参与单位名称 | 国信证券、银河证券、国联民生、华泰证券、中泰证券、天风证券、宏道投资、国新投资、禾永投资、申万菱信、达奇投资、大家资产、暖逸欣基金、胤胜资产、拾贝投资、浙商资管等 |
| 时间 | 2026年5月21日 |
| 地点 | 现场会议 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长 何洪臣 董事会秘书 侯磊 投关总监 李伍明 副总经理 张长元 技术总监 任其广 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1. 公司SST研发仅用约一个季度即推出首台样机，公司核心研发优势与技术积累体现在哪里？</p> <p>答：公司早在2017-2018年就做过相关拓扑的产品和项目研发，产品虽有迭代，但电路拓扑高度同源。本次SST方案交流侧采用10kV级联H桥拓扑、直流侧采用DAB成熟方案，同时公司也有LLC技术；明确功率2.5MW、输出电压800Vdc等参数以后快速实施落地。核心优势： ①10kV高压侧成熟技术；②800V DCDC成熟技术；③结构设计方案成熟；④国产碳化硅器件应用成熟，仅高频变压器为新增物料，依托成熟供应商快速落地。</p> |

2. 公司2.5MW产品是否送样？测试周期与认证计划如何？国内是否已有国标？

答：产品尚未量产，暂未对外送样。首轮全面测试计划6月底前完成，含功能、性能、环境可靠性等全项验证；测试完成后启动国内认证，后续量产仅需简化工厂出厂测试。当前SST无国家标准，执行相关的企业标准、行标、团标，部分客户有自定义需求标准。

3. 如何看待SST新进入者？公司核心壁垒与客户认证壁垒是什么？

答：SST属高压、大电流、高频化综合电力电子装置，参数要求严苛，外行跨界门槛高。公司核心壁垒：①多年高电压大功率电力电子技术沉淀；②系统化制造与测试体系；③成熟供应链与现场服务体系。新产品从实验室到批量可靠应用需长期验证，公司具备全流程能力保障产品落地。

4. 公司当前SST采用硅+碳化硅混合方案，后续技术路线如何规划？

答：当前混合方案为过渡性验证方案：10kV侧频率要求较低，采用硅器件；DCDC侧频率高（20kHz - 50kHz），采用碳化硅器件。该方案可兼顾效率、发热、成本，对输入侧有较高的可靠性保证和现场数据，验证效果良好。后续第二款机型将全面采用碳化硅，进一步提升效率、降低发热等性能。

5. 高频隔离变压器的技术壁垒与国内供应情况如何？

答：高频变压器核心要求“两高一”：高频、高压、大电流，需解决绝缘耐压、局放、散热、电磁干扰等难题。国内具备高压绝缘与高频工艺能力的供应商较少，价格偏高；工艺成熟后成本具备大幅下降空间，为公司重点掌控的核心部件。

6. 未来规划35kV SST，技术难点主要在哪里？

答：35kV规划在液冷方案成熟后启动，面向5MW及以上大功率场景。核心难点仍在高频变压器，绝缘等级需提升，拓扑与碳化硅器件要求与10kV差异不大，仅单元数量增加。

7. 公司SST采用的DAB、LLC等拓扑与同业方案对比，优势与适用

| | |
|------------------------------------|---|
| | <p>场景是什么？</p> <p>答：DAB：支持能量双向流动，可充电可放电，具备回馈功能，适配需双向功率的场景，适应宽电压范围调整；</p> <p>LLC：单向流动，效率相对更高，适配数据中心等单向供电场景，公司已掌握成熟技术，但适配调整电压范围窄；</p> <p>模块化多电平：与公司调相机等产品技术同源，可根据场景灵活选用。</p> <p>8. 公司储能业务聚焦PCS还是系统集成？高压级联PCS优势与应用场景？</p> <p>答：储能主力产品为PCS、BMS、EMS，以高压级联储能、集中式储能（构网型）为重点。高压级联方案优势：①系统效率可达90% - 92%，显著高于集中式；②天然适配构网技术，单台功率大、并机数量少，环流风险低；③对电池更友好，单簇独立控制，减少不均衡与老化，提升长期利用率。今年高压级联订单占比明显增多。</p> |
| <p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p> | <p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p> |
| <p>附件清单（如有）</p> | <p>无</p> |
| <p>日期</p> | <p>2026年5月21日</p> |